



各 位

平成 14 年 7 月 26 日

平成 15 年 3 月期 第 1 四半期の業績等の概況

上場会社名 メ ッ ク 株 式 会 社

(コード番号：4971 大証 NJ スタンダード)

本社所在地 兵庫県尼崎市昭和通3丁目9番地

問 合 せ 先 社長室長 坂本 佳宏

TEL 06-6414-3451

1 業 績

(注) 百万円未満切捨て

(1) 平成 15 年 3 月期 第 1 四半期 (平成 14 年 4 月 1 日～平成 14 年 6 月 30 日) の連結業績

	平成 15 年 3 月期 第 1 四半期 (当四半期)	対前年同 期増減率	平成 14 年 3 月期 第 1 四半期 (前年同四半期)	参 考 前期 (通期)
	百万円	%	百万円	百万円
売 上 高	1,437	8.7	1,322	5,228
営 業 利 益	157	99.9	78	518
経 常 利 益	123	62.0	75	530
当 期 純 利 益	91	53.0	59	289

(注) 記載金額は、平成 15 年 3 月期第 1 四半期の連結の業績であり単体の業績につきましては、「4 その他 第 1 四半期の単体の業績」に記載しております。

(2) 部門別の連結売上高内訳

	平成 15 年 3 月期 第 1 四半期 (当四半期)		対前年同 期増減率	平成 14 年 3 月期 第 1 四半期 (前年同四半期)		参 考 前期 (通期)	
	金 額	構成比		金 額	構成比	金 額	構成比
	百万円	%	%	百万円	%	百万円	%
電子基板用薬品	1,196	83.2	11.3	1,074	81.3	4,369	83.6
電子基板用機械	149	10.4	△6.3	159	12.1	563	10.8
電子基板用資材	69	4.8	△11.7	78	5.9	252	4.8
そ の 他	22	1.6	130.1	9	0.7	43	0.8
合 計	1,437	100.0	8.7	1,322	100.0	5,228	100.0

(3) 主な資産・負債の変動について

項目	平成 15 年 3 月期 第 1 四半期 (当四半期)	増減額	前期末
(資産)	百万円	百万円	百万円
現金及び預金	1,553	△217	1,770
受取手形及び売掛金	1,989	185	1,803
建物及び構築物	1,197	492	704
建設仮勘定	14	△289	303
(負債)			
支払手形及び買掛金	740	205	535
短期借入金	664	△89	754

(注) 1. 項目ごとの変動額が、総資産額の 1%を超えるものを記載いたしております。

2. 当四半期に係る数値について、公認会計士または監査法人の監査を受けておりません。

2 業績の概況

当社の製商品は、携帯電話やパソコン等の情報通信機器を始め、各種のデジタル家電や自動車、医療検査機器など全てのエレクトロニクス製品に搭載されている電子基板の製造工程で使用されております。

当第 1 四半期における当社の経営環境は、世界的には“IT不況”からの緩やかな回復段階となりました。日本国内のエレクトロニクス産業においても、一部に回復傾向を示している分野もあるものの、為替動向など不確定要素や個人消費、民間設備投資とも盛り上がりには欠け依然として厳しい状況にあります。

当社の顧客市場である電子基板業界に関しても、パッケージ基板等部分的には明るさが見え始めましたが、総じて不透明な状況が続いております。また、生産業務の中国へのシフトが急速に進んでおります。

このような状況下において当社では、世界市場での競争力向上を図るため、マーケティング機能を強化するとともに、カスタマサービス部門の人員を増強し、より緻密な顧客対応に取り組んでおります。更に、急成長市場である中国（江蘇省蘇州市）に昨秋開設した子会社（MEC CHINA SPECIALTY PRODUCTS CO.LTD）は、4月より生産・販売業務を開始し、5月には研究所増築工事が完成し、今後の事業拡大に向けた体制整備を進めました。

当四半期における連結業績の概要は次のとおりであります。

(1) 売上高

当第 1 四半期の合計売上高は、14 億 37 百万円（前年同期比 8.7%増）となりました。このうち、電子基板用薬品の売上高は、11 億 96 百万円（前年同期比 11.3%増）となりました。パソコン MPU 用パッケージ等の高密度電子基板用途での販売割合が高い銅表面超粗化剤 CZ シリーズを含む銅表面処理剤は、比較的堅調に推移し、7 億 7 百万円（対前年同期比 19.6%増）となりました。その他、銅表面を有機皮膜で保護する防錆剤は 1 億 64 百万円（対前年同期比 19.4%増）、銅表面をはんだで保護する際に用いるフラックス剤が 2 億 33 百万円（対前年同期比 1.2%増）、はんだを溶解除去するメタルレジスト剥離剤が 68 百万円（対前年同期比 16.3%減）となりました。

電子基板用機械の売上高は、1 億 49 百万円（対前年同期比 6.3%減）と引続き設備投資低迷の影響を受ける結果となりました。

(2) 営業利益及び経常利益

電子基板用薬品が緩やかな回復基調となったために営業利益は 1 億 57 百万円（対前年同期比 99.9%増）となりました。経常利益は 1 億 23 百万円（対前年同期比 62.0%増）となりました。

3 当期の見通し

今後の世界経済の動向は、引続き不透明な状態が続くものと思われま

す。電子基板市場は台湾・韓国・中国などのアジアで生産増加の傾向が見込まれております。

当社グループはこれら地域の販売に注力するため経営資源を集中投入していく所存であります。また、引き続き製造コストと販売費及び一般管理費の抑制を徹底し収益体質の強化を推進してまいります。

なお通期(平成14年4月1日～平成15年3月31日)の見通しにつきましては、平成14年5月20日の決算発表に下記の通り公表した連結・単体業績予想と、現時点での変更はございません。

平成15年3月期の連結業績予想(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円
通 期	5,933	771	470

(参考) 1株当たり予想当期純利益(連結) 92円 46銭

平成15年3月期の業績予想(平成14年4月1日～平成15年3月31日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期 末	
	百万円	百万円	百万円	円 銭	円 銭
通 期	4,311	401	232	15 00	15 00

(参考) 1株当たり予想当期純利益 45円 70銭

※ 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことはお差し控え下さい。

4 その他

第1四半期の単体の業績

	平成15年3月期 第1四半期 (当四半期)
	百万円
売 上 高	1,131
営 業 利 益	79
経 常 利 益	27
当 期 純 利 益	14

以上